

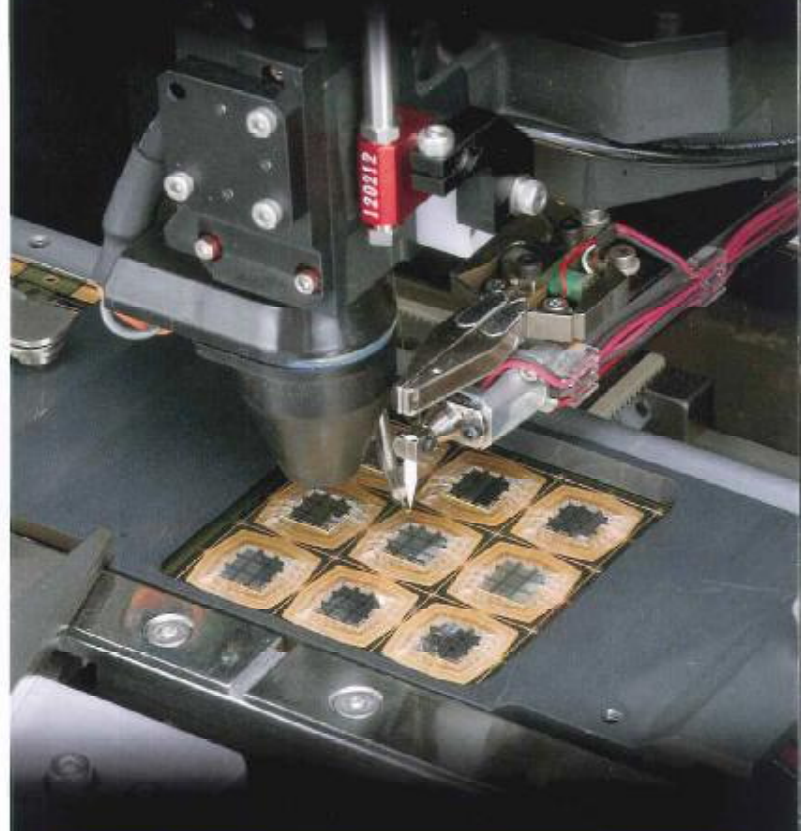
**KAIJO**

# FB-988 *New*

高品质的焊接方式

面向高端产品的新型全自动焊线机

*Sophisticated Wire Bonder capable of  
high quality bonding performance*



## FB-988的特点

- \*通过新开发的高刚性·超轻型焊头，达到超高的精度以及超低的冲击压力
  - 使用复合材料制成的焊线摆臂
  - 超小型超轻型1701型迷你振动子
  - 搭载高速接触检测功能
- \*超大的焊线区域
  - 可对应工件尺寸：295mm ( X ) x 100mm ( Y )
- \*对应合金线 ( Ag/Cu ) 焊接 ( 选配 )
- \*全新Windows 界面·舒适的新型操作环境

## Features of FB-988

- \* New bonding head, rigid and lightweight satisfies high accurate bonding performance and low impact load to boards
  - Composite bonding arm
  - 1701 lightweight mini-horn
  - High speed touch detector
- \* Capable of wide area bonding
  - Work size up to 295mm(X) × 100mm(Y)
- \* Capable of alloy wire (Ag/Cu) bonding optionally
- \* User friendly new operational environment by Windows

# FB-988

Sophisticated Wire Bonder capable of high quality bonding performance

## ■ 主要规格

<b>焊线性能</b>	
重复焊线精度 (不包含自身编辑精度)	±2.0 μm(3σ) ※根据对应品种需要精度稳定化
焊线范围	56mm × 88mm
图像识别系统	高速·高精度图像处理引擎 1/3" CCD摄像机 2.1/6倍镜头
<b>线弧特性 (使用线径为25时)</b>	
线长	最大8.0mm
弧高	标准模式/100 μm FJ线弧/65 μm
弧度	线长的1%以下
<b>焊线能力</b>	
焊线速度	45msec/线
图像识别时间	100msec/2点 (□5mm 芯片时)
Lead识别时间	11msec/Lead (监控器内有3个支架的情况)
<b>搬送系统</b>	
支架的尺寸	宽度 : 30mm~100mm 长度 : 90mm~295mm 厚度 : 0.1mm~0.5mm
料盒	宽度 : 30mm~110mm 长度 : 95mm~300mm 高度 : 100mm~175mm 存放数量 : 2~3个料盒
<b>操作性</b>	
显示器	20"彩色显示器
操作面板	持久耐用的专用开关 附带3个按钮鼠标操作
<b>外部通讯</b>	
	HSMS标准配置 USB存储器
<b>应用条件</b>	
干燥压缩空气	0.3~0.97MPa(3.1~9.9Kgf/cm <sup>2</sup> ) 35NL/min
真空	-53.32KPa以下(400mm/Hg以上)
供电电压	AC200V、50/60Hz、±5%以下 (AC220、240V可选择)
最大消耗电力	约1.5KVA
外观尺寸	W780 × D1085 × H1748mm (包括信号灯H2062mm)
重量	550kg

## ■ SPECIFICATIONS

<b>Bonding</b>	
Repeatability of Bonding Accuracy (Excluding Self-Teach Accuracy)	±2.0 μm(3σ) ※Special kit for accuracy stability may be required depending on devices.
Bonding Area	56mm × 88mm
Recognition System	High Speed-High Accuracy Process Engine 1/3" CCD Camera 2.1 and 6 magnification lens
<b>Looping (In the case of wire diameter 25 μm)</b>	
Wire Length	8.0mm in max
Loop Height	Standard mode 100 μm FJ Loop 65 μm
Wire Curl	Less than 1% of the wire length
<b>Productivity</b>	
Bonding Time	45msec/wire
Recognition Time	100msec/2 points (□5mm Chip)
Lead Locate(VLL)Time	11msec/lead (in the case of 3 leads within a monitor)
<b>Indexing System</b>	
Package Frame Size	Width : 30mm~100mm Length : 90mm~295mm Thickness : 0.1mm~0.5mm
Magazine	Width : 30mm~110mm Length : 95mm~300mm Height : 100mm~175mm No. of Stock : 2~3 Magazines
<b>Operability</b>	
Monitor	20" color Wide LCD
Operation Panel	Operation by mouse with 3 buttons
<b>External Interface</b>	
	HSMS USB memory
<b>Utility</b>	
Air	0.3~0.97MPa(3.1~9.9Kgf/cm <sup>2</sup> ) 35NL/min
Vacuum	-53.32KPa or less (400mm/Hg or more)
Power Source	AC200V、50/60Hz、±5% or less (AC220、240V option)
Power Consumption	Approx. 1.5KVA
Overall Dimensions	W780 × D1085 × H1748mm (H2062mm, including indicating lamp)
Weight	550kg

⚠ 安全注意事项: 为了安全使用产品, 使用前请仔细阅读操作说明书。

●目录上的注意点... 目录上所刊载商品的规格以及外观如有所改良恕不另行通知, 请知悉。

⚠ CAUTION FOR SAFE: Please read surely INSTRUCTION MANUAL before operate.

●Specification is subject to change without prior notice for improvement.

**KAIJO** KAIJO CORPORATION URL: <http://www.kaijo.co.jp>

日本总公司: 焊线事业部

东京都羽村市栄町3-1-5 〒205-8607 TEL 81-42-555-6162 FAX 81-42-579-5175

上海楷捷半导体科技有限公司

KAIJO SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD.

上海市闵行区莲花路1733号D栋109室

TEL 021-62751515 FAX 021-32160677

URL: <http://www.kaijo.cn>